

檔 號：

保存年限：

國立臺北科技大學 函

地址：106344臺北市大安區忠孝東路三段一號

承辦人：賴建成

電話：2771-2171#6020

電子信箱：lks@ntut.edu.tw

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國114年6月16日

發文字號：北科大產學字第1147900178號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：114年半導體IC晶片封測製程技術菁英人才培育計畫課程表、114年半導體IC晶片封裝製程技術菁英人才培育計畫海報

主旨：檢送本校與明新科技大學半導體學院合作辦理114年「半導體IC晶片封測製程技術菁英人才培育計畫」課程資訊（詳如說明），敬邀貴校學生踴躍報名參加，並請協助公告，請查照。

說明：

- 一、本課程旨在培育具備產業即戰力的半導體技術人才，內容涵蓋台灣在全球半導體產業中的戰略地位、產業鏈介紹、技術趨勢解析，以及半導體在日常生活中的應用等理論基礎；實作課程的部分，學員將親自操作晶圓切割機、打線機、黏晶機等封裝設備，並進行功率IC測試設備操作訓練，包括晶圓針測試機與高功率元件測試機等，深入了解2D/3D封裝、WLP與PLP等先進製程技術。透過理論與實務並重的安排，幫助學生建立完整的半導體封測技術知識體系，奠定相關職能基礎。
- 二、報名資格：國內各公私立大專校院之在學學生。
- 三、課程時間：114年7月17日（四）、114年7月18日（五）共計2天，凡符合報名資格且參與全程課程者，於課程結束後擇期核發研習時數證明電子檔。
- 四、課程地點：明新科技大學逢喜樓209教室、明新科技大學半導體人才培育基地(新竹縣新豐鄉新興路1號)。
- 五、人數上限：實體30人（無線上課程）。
- 六、報名時間：即日起至114年7月14日（一）17:00為止（如人數額滿將提前截止）。



- 七、報名網址：<https://forms.gle/jXWh6J3RfEPsDRav9>
- 八、聯絡人：教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學賴專員，連絡電話:(02)2771-2171分機6020，電子郵件：lks@mail.ntut.edu.tw
- 九、本課程與美銘國際科技有限公司、力成科技股份有限公司合作辦理。
- 十、檢附114年「半導體IC晶片封測製程技術菁英人才培育計畫」課程表、海報。

正本：各公私立大專校院

副本：本校產學處、明新學校財團法人明新科技大學半導體學院、美銘國際科技有限公司、力成科技股份有限公司

電子公文
交換章

——批核軌跡及意見——

